

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2019

Data sporządzenia: 2019-04-05

Skrócona nazwa emitenta

MODULE TECHNOLOGIES S.A.

Temat

Informacja w sprawie wykupu obligacji imiennych serii A

Podstawa prawna


Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że w dniu 05 kwietnia 2019 r. dokonał wykupu obligacji serii A w terminie wykupu, wynikającego z Warunków emisji tych obligacji. Tym samym dokonano wykupu 77% wyemitowanych obligacji serii A (w liczbie 5 385 sztuk o wartości nominalnej 1 000 złotych każda) za łączną wartość 5 385 000 zł. Jednocześnie Zarząd informuje, że pozostała część obligacji serii A w liczbie 1 615 szt., w związku z zawartymi porozumieniami z Obligatariuszami (na mocy których zmianie uległ termin wykupu tych obligacji), zostanie wykupiona najpóźniej do dnia 08 maja 2019 r. Oprocentowanie obligacji, których termin wykupu został przesunięty ustalono na 12 % w stosunku rocznym, a płatność odsetek nastąpi w momencie wykupu tych obligacji.

MODULE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
MODULE TECHNOLOGIES S.A.	Usługi Inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300	Bielsko-Biała
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Hugona Kołtąja	14/6
(ulica)	(numer)
+48 32 210 18 26	+48 32 210 18 26
(telefon)	(fax)
zarzad@lstechhomes.com	www.lstechhomes.com
(e-mail)	(www)
5472105335	241140645
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-04-05	Mirosław Pasieka	Prezes Zarządu	
2019-04-05	Daniel Pihan	Członek Zarządu	